



推奨基板取付け寸法
 PC 基板厚: 1.6±0.1
 (非累積公差)
 (コネクタ搭載面)

RECOMEND PC BOARD HOLE PATTERN
 PC BOARD THICKNESS: 1.6±0.1
 (NOT ACCUMULATE TOLERANCE)
 (CONNECTOR MOUNT SIDE)

- NOTES
- MATERIAL: HOUSING: GLASS FILLED THERMO PLASTIC, POLYESTER(94V-0), COLOR: BLACK
 CONTACT: COPPER ALLOY
 RETENTION LEG: COPPER ALLOY
 - FINISH (CONTACT AREA): 0.38μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
 - FINISH (CONTACT AREA): 0.76μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
 - FINISH (CONTACT AREA): 2.0 μm MIN TIN PLATED OVER NICKEL
 - FINISH (RETENTION LEG): TIN-LEAD PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL
 - FINISH (RETENTION LEG): TIN PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL
- 注記
- 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂 (94V-0), 色: 黒
 コネクタ: 銅合金
 リテンションレグ: 銅合金
 - めっき: コネクタ: 全面Ni下地
 接触部: 0.38μm MIN金めっき
 - めっき: コネクタ: 全面Ni下地
 接触部: 0.76μm MIN金めっき
 - めっき: コネクタ: 全面Ni下地
 接触部: 2.0 μm MINスズめっき
 - めっき: リテンションレグとコネクタ半田付部
 : ニッケル下地の上に半田めっき
 - めっき: リテンションレグとコネクタ半田付部
 : ニッケル下地の上にスズめっき

DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

AMP-J
REV.10/83

KEYING LOCATION		KEYING	FINISH	PART NO.
[Diagram]		Y	△6 △4	2-316132-5
[Diagram]		X	△6 △3	2-316132-3
[Diagram]			△6 △2	2-316132-2
[Diagram]			△6 △4	1-316132-5
[Diagram]			△6 △3	1-316132-3
[Diagram]			△6 △2	1-316132-2

Copyright © 1995 AMP(Japan) LTD. ALL RIGHTS RESERVED.				Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan	
WIRE RANGE		INSULATION DIA		NAME	
mm²(AWG -)		mmφ		ダイナミック D-3200S 5.08 ピッチ (V) 5 極 ヘッダーアセンブリー	
MATERIAL		FINISH		DYNAMIC D-3200S 5.08PITCH(V) 5 POS.HDR CONN.ASS'Y	
SEE NOTES		SEE NOTES		一般公差 (GENERAL TOLERANCE)	
注記参照		注記参照		SIZE LOC NUMBER	
DR. 26/JUL/95		DE. 26/JUL/95		A3 J C=316132	
K.IKEDA		K.IKEDA		SCALE REV. SHEET	
2/AUG/95		2/AUG/95		2-1 B 1 OF 1	
CHK. Y.ISHIKAWA		APP. S.MANABE			
LTR REVISION RECORD		DR CHK DATE			